3B01

Au(111)上ジベンゾペンタセンの価電子状態とホールー振動カップリング (東大院・総合¹, 横国大・理工²) 〇鈴木 敦¹, 佐藤博史¹, 青木 優¹, 首藤健一², 増田 茂¹ Valence electronic structure and hole-vibration coupling of dibenzopentacene on Au(111)

(Univ. of Tokyo¹, Yokohama National Univ.²) oAtsushi Suzuki¹, Hirofumi Sato¹, Masaru Aoki¹, Ken-ichi Shudo², Shigeru Masuda¹

【序】

有機半導体はソフトマテリアルの典型であり、その特性から基礎物性のみならず、有機太陽電 池や有機 EL などデバイスへの応用研究が盛んに行われている. 有機半導体結晶は弱い van der Waals 相互作用によって形成しており、分子間で緩く結合した HOMO(最高被占軌道)や LUMO(最 低空軌道)等のπ軌道が電気伝導に関与する. また、これらのπ軌道は有機-金属界面における電 荷注入過程においても重要な役割を果たす. このような電荷輸送機構に決定的な影響を与える有 機薄膜の電子構造を調べる上で、電子分光は直接的かつ有効的な手法である. 本研究では、Au(111) 基板上に作製したジベンゾペンタセン(DBP)超薄膜を取り上げ、紫外光電子分光(UPS)、準安定原 子電子分光(MAES)、第一原理計算(DFT)を適用し、価電子構造や特に、HOMO バンドのホールダ イナミクスを明らかにすることを目的とした. なお、MAES は試料最外層の価電子状態を選択的 に観測できる特徴をもつ[1].

【実験】

実験には超高真空電子分光装置(base pressure: 6.0×10⁻¹¹ Torr)を用いた[1]. UPS, MAES のプロ ーブには He I 共鳴線(*hv* = 21.22 eV), He^{*}(2³S, 19.82 eV)をそれぞれ用いた. Au(111)基板は Ar⁺ スパッタリングと電子衝撃加熱(~ 900 K)を繰り 返すことで清浄化した. DBP 超薄膜は,室温の 基板に蒸着速度 0.1 Å・min⁻¹以下で真空蒸着す ることで作製した. 膜厚は水晶振動子膜厚計で 制御した. 試料の冷却にはクライオスタットを 用いた. 孤立分子・イオンの電子状態や振動状 態は C_{2h}を仮定して計算した.

【結果と考察】

Fig. 1 に Au(111)基板に作製した **DBP** 薄膜の 膜厚依存 **UPS** スペクトルを示す. 横軸は基板の フェルミ準位(*E*_F)を基準とした結合エネルギー (*E*_B),縦軸は放出電子強度を示す. スペクトル の右側の数値は **DBP** 膜厚の平均値を示す. 蒸着 量の増加とともに Au 基板由来のバンド(**sp**, 5d)



Fig. 1: DBP/Au(111)の UPS スペクトル

が弱くなり, DBP 分子軌道由来のバンドが観測された[2]. 注目すべき点は, 単分子層形成過程(2.1, 3.1 Å)のスペクトルにおいて, HOMO(π_{15})バンド a の高 E_B 側に微細構造(X, Y)が観測されたこと である. 4.7 Å から 2 層目由来の HOMO バンド b が出現し, 微細構造は消失する. これは 1 層目 と 2 層目のバンドが重なったためであると考えられる.

Fig. 2 に HOMO バンドの UPS スペクトル(o)とピークフィッティングの結果を示す.前者は 4.2 Å 薄膜を 370 K でアニールした後,基板温度 55 K まで冷却して測定した.横軸は HOMO バンド のピークを 0 とした.図中の破線は Voigt 関数(Gauss 関数と Lorentz 関数の畳み込み),実線は破線 を足し合わせたものである.HOMO バンドはほぼ等間隔の 3 成分に分離され,フィッティングカ ーブによりよく再現される.各成分のエネルギー間隔は~160 meV となった.これは気相ペンタセンの UPS で観測される HOMO バンドの微細構造のエネルギー(167 meV)[3]に近く,光イオン化後 に生成した DBP⁺イオンの C-C 伸縮振動に帰属される.これは孤立した DBP⁺イオンの MO 計算 によっても確かめられた.このような振動構造は,HOPG 基板上のペンタセンでも観測されてい るが[3],金属基板上での観測例は今回が初めてである.

Voigt 関数のうち Gauss 関数(半値幅: W_G)はフェルミ分布とアナライザーのエネルギー分解能に よる拡がり,Lorentz 関数(半値幅: W_L)は寿命による拡がりを反映すると考えられる.第一ピーク では $W_G = 100$ meV, $W_L = 110$ meV であった. W_L 値からホール寿命(τ)を見積もると, 6.0 fs であっ

た. この値は C-C 伸縮振動の周期(26 fs)の約 23 %に相当する. また,振動構 造の強度分布はポアソン分布($I_n = S^n e^{s'}/n!$)に従うことが知られている. 振 動強度比から求められる S 因子と振動 エネルギーを用いて,電荷と分子振動 の結合程度を表す再配列エネルギー (λ_{reorg})を求めた. 4.2 Å 薄膜では $\lambda_{reorg} =$ 131 meV となった. λ_{reorg} はホール移動 度にとって,分子間トランスファー積 分と並んで重要な値である. 同様な解 析を 1.8 Å 薄膜についても行った.

発表では,第一原理計算で得られた Au(111)基板上における DBP の分子配 向と実験結果との比較も行う.



参考文献

[1] M.Aoki et al. J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. 156, 383 (2007).

- [2] B. Mahns et al. Phys. Rev. B. 86, 035209 (2012).
- [3] H. Yamane et al. Phys. Rev. B. 72, 153412 (2005).